

Effective date: Contact information: Type of notification: Change Category: Change Sub-Category(s):	This Product Bulletin is for notification purpose of this change upon publication of this Product				
Гуре of notification: Change Category:	This Product Bulletin is for notification purpose of this change upon publication of this Product		15 May 2019		
Change Category:	of this change upon publication of this Product	s only. ON Se	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <york.yu@onsemi.com></york.yu@onsemi.com>		
		This Product Bulletin is for notification purposes only. ON Semiconductor will proceed with implementation of this change upon publication of this Product Bulletin.			
Change Sub-Category(s):	Wafer Fab Change Assembly Change	e 🗌 Test	Change		
	Material Change				
Manufacturing Site Addit	ion Product specific change	🗌 D	atasheet/Product Doc change		
Manufacturing Site Transf		SI	nipping/Packaging/Marking		
Manufacturing Process Ch	ange	▼ 0	ther: <u>Add New T7 Taping Devices</u>		
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Leshan, China		xternal Foundry/Subcon Sites: one		
Description and Purpose:					
mprovement since minimizing	and function of products as existed T1 taping opt and Onsemi web commends customers convert existing T1 tapin set-up loss and reduce wastage (clean environme	ion devices, l ng option dev ent).	vice to T7 taping option device for producti		
ON Semiconductor strongly reamprovement since minimizing s	and function of products as existed T1 taping opt and Onsemi web commends customers convert existing T1 tapin	ion devices, l ng option dev ent). T1 taping op	but QTY per Reel is larger than T1, these T7 op vice to T7 taping option device for producti tion: T7 Taping Option Devices (New created		
DN Semiconductor strongly reamprovement since minimizing selected by the selec	and function of products as existed T1 taping opt and Onsemi web commends customers convert existing T1 tapin set-up loss and reduce wastage (clean environme he key comparison/differences between T7 and T1 Taping Option Devices (existi	ion devices, l ng option dev ent). T1 taping op	out QTY per Reel is larger than T1, these T7 op vice to T7 taping option device for producti tion: T7 Taping Option Devices (New created OPNs)		
ON Semiconductor strongly reamprovement since minimizing s	and function of products as existed T1 taping opt and Onsemi web commends customers convert existing T1 tapin set-up loss and reduce wastage (clean environme he key comparison/differences between T7 and T1 Taping Option Devices (existi 3,000 / Tape & Reel	ion devices, l ng option dev ent). T1 taping op	but QTY per Reel is larger than T1, these T7 op vice to T7 taping option device for producti tion: T7 Taping Option Devices (New created		

Japanese translation of the notification starts here. 通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注:日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先さ れます.



変更件名:	MOSFET SOT23 パッケージ向け T7 テーピングオプションデバイスのご利用について			
発効日:	15 May 2019			
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < York.Yu@onsemi.com> にお問い合わせください。			
通知種別:	本製品速報は通知目的のみのものです。オン・セミコンダクターは本製品速報の発行により本変更を実行します。			
変更カテゴリ:	□ ウェハファブの変更 □ アセンブリの変更 □	試験の変更		
変更サブカテゴリ:				
 □ 製造拠点の追加 □ 製造拠点の移転 □ 製造プロセスの変更 	 □ 材料の変更 □ 製品仕様の変更 	 □ データシート/製品資料の変更 □ 出荷/パッケージング/表記 ☑ その他: <u>新 T7 テーピングデバイスの追加</u> 		
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点 : ON Leshan, China	外部製造工場 / 下請業者拠点:		

説明および目的:

オン・セミコンダクターは、MOSFET SOT23 パッケージのいくつかの T7 テーピングオプションデバイスがご利用可能となったことをお知らせします。T7 テーピン グオプションデバイスは製品として既存の T1 テーピングオプションデバイスと同じ形状、適合性、および機能を持っていますが、リールごとの個数が T1 より 多くなっています。これらの T7 オプションデバイスはデータシートおよび オン・セミコンダクターのホームページでご覧いただけます。

オン・セミコンダクターは、セットアップロスの最小化による生産性向上、および廃棄物の削減(クリーンな環境)のために、既存の T1 テーピングオプション デバイスから T7 テーピングオプションデバイスに変更することを強く推奨します。

T7 および T1 テーピングオプションの主な比較/相違に関しては、以下の表を参照ください。

	T1 テーピングオプションデバイス (既存 OPNS)	T7 テーピングオプションデバイス (新規 OPNs)
テープおよびリール数	3,000 / テープ & リール	3,500 / テープ & リール
部品番号 - テープおよびリールオプション 識別	T1 例: (2N7002E <mark>T1</mark> G)	T7 例: (2N7002E <mark>T7</mark> G)

影響を受ける部品の一覧:

注: 標準の部品番号(既製品)のみが部品一覧に記載されます。本 PCN に影響を受けるカスタム 部品は、PCN メールの顧客の特定の PCN の付属 文書、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

2N7002ET1G

2N7002KT1G

2N7002LT1G

2N7002LT1H

BSS123LT1G

BSS138LT1G

BSS84LT1G

Appendix A: Changed Products

D

Product	Customer Part Number
2N7002ET1G	
2N7002KT1G	
2N7002LT1G	
BSS123LT1G	
BSS138LT1G	
BSS84LT1G	